

Informations de base	
<b>2018/2947(DEA)</b>	Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur
DEA - Procédure d'acte délégué	
Exemption relative au plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée	
Complétant <a href="#">2008/0240(COD)</a>	
<b>Subject</b>	
3.40.06 Industries électronique, électrotechnique, TIC, robotique	
3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage, transport)	

Informations techniques	
Référence de la procédure	2018/2947(DEA)
Type de procédure	DEA - Procédure d'acte délégué
Sous-type de procédure	Examen d'un acte délégué
Modifications et abrogations	Complétant <a href="#">2008/0240(COD)</a>
État de la procédure	Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur
Dossier de la commission	ENVI/8/15029